

## 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）至 5 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [jhtdesign@jht-design.com](mailto:jhtdesign@jht-design.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告、2022 年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标及 2022 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在

信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 召开时间：2023年5月19日(星期五) 下午 14:00-15:00

(二) 召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

## 四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）至 5 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [jhtdesign@jht-design.com](mailto:jhtdesign@jht-design.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

联系电话：021-52277906

联系传真：022-89129719

联系邮箱：[jhtdesign@jht-design.com](mailto:jhtdesign@jht-design.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023年4月26日